

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2026-027

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于上海证券交易所有关监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”“安德利”）于2026年6月15日收到上海证券交易所下发的《关于烟台北方安德利果汁股份有限公司收购事项的监管工作函》（上证公函【2026】1072号，以下简称“《监管工作函》”）。公司第一时间组织管理层、财务、证券、法务及合作中介机构，结合尽调资料、标的公司详细经营数据、行业数据逐项核查落实，现就《监管工作函》所列问题逐一回复并风险提示如下：

风险提示

（一）本次交易存在重大不确定性风险
本次交易在推进中，受资本市场环境、监管政策、行业及经营形势等多重因素影响，交易各方相关决策均可能发生变动，本次交易存在暂停、中止或终止的风险，最终能否顺利实施尚存在重大不确定性。本次股权转让事项的推进尚需取得标的公司股东放弃优先受让权、共同出售等特殊权利的书面确认，存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）标的公司盈利能力改善的可持续性风险
标的公司2024年度、2025年度持续亏损，2026年一季度，虽实现盈利但处于微利状态。标的公司目前收入结构仍以PR4产品为主，高端产品技术产业化、获得验证通过、实现量产尚具有不确定性，2026年毛利率仍较低。M8等级以上的高端覆铜板需求量大程度取决于终端客户产品研发和投入量产的周期，该周期对出口产品增速无法匹配，标的公司技术产业化后，或者开发、订单获取情况不佳，或者标的公司无法有效提供供应链管理服务，导致成本上甚至无法供货，标的公司的盈利能力改善将存在不确定性，有较大的可持续性风险，2026年全年是否能够实现盈利无法合理预计。

（三）标的公司面临较强的行业竞争风险
标的公司收入，市场有较多有资深产线规模相比行业头部企业仍较大差距，标的公司2025年收入结构仍以PR4产品为主，占比73.00%、代工占比13.70%、高速覆铜板占比5.82%，高端覆铜板占比3.87%，PR4产品、高端产品均面临行业头部企业较大竞争压力，标的公司能否进一步取得市场份额、未来高端产品收入是否能够实现进一步成长、产品结构是否能够进一步优化尚存不确定性，行业竞争风险较大。

（四）标的公司核心技术被迭代的风险
由于标的公司所处细分行业具有产品认证周期较长的典型特征，且终端客户验证需与PCB企业协同进行，下游客户对材料的技术指标、可靠性及长期供应能力要求严苛，新品从导入到规模化应用通常需经历较长的验证周期，高端客户信息互连新材料技术更新快，若未来研发投入不足、新品落地滞后，中长期存在被技术迭代的风险。

（五）审计、评估尚未完成，交易价格尚未确定的风险
截至本回复出具日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估价值及交易价格尚未确定。标的资产的公允价值由中介机构聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为基础，由交易各方协商确定。本回复引用标的公司的财务数据为未经审计的母公司财务数据，标的公司审计后的财务数据可能与本回复披露数据存在较大差异，敬请广大投资者注意。此外，若交易各方对最终交易价格无法达成一致，本次交易将面临终止或取消的风险。

（六）本次交易的收购整合风险
公司目前主营业务未涉及集成电路电子信息互连材料相关技术领域经营，无相关行业领域的人才、技术、客户及供应商储备，上市公司与标的公司在业务和管理模式等方面所所属行业不同存在一定差异，上市公司将给标的公司的业务特点，进一步加强管理能力和、完善管控能力以适应业务变动及规模扩张，但是否能够有效整合并执行效果存在不确定性，导致上市公司管理水平不适应本次交易后上市公司业务变化或规模扩张的风险，从而对公司开展业务和提高经营业绩产生不利影响。

（七）本次交易和财务资金流动性风险
截至2026年3月31日，公司账面货币资金及交易性金融资产余额为人民币7.17亿元，公司本次交易资金通过自有、自筹等方式解决，短期内会对公司产生一定资金压力。

（八）商誉减值风险

本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年终进行减值测试。如果标的公司未来经营状况未达预期，将产生商誉减值的风险，从而对上市公司未来经营业绩产生不利影响。

问题1：关于本次收购的商业合理性

安德利公司主营覆铜板的生产及销售，标的公司主营集成电路电路板电子信息互连材料的生产、生产和销售业务，2025年净利润为负，公司未发生经营性亏损。根据公开信息，最近股份（300658）于2026年5月18日被强制发行股份及支付现金购买南强科技98.54%股权并募集配套资金事项，距离本协议签署时间不足1个月。

请公司补充披露：（1）标的公司所处细分行业的市场规模、竞争格局、技术发展趋势，标的公司的核心技术是否符合技术发展趋势，是否存在被迭代的风险，结合标的公司的经营规模、市场占有率等说明其所处行业地位和竞争优势优势；（2）分产品类别说明标的公司技术产业化情况、产品验证进展，是否实现规模化量产，与主要客户的合作阶段及收入实现情况；（3）本次交易收购后整合管控的措施安排，标的公司是否具备跨行业经营的经验、能力，如何保障对子公司的有效管理；（4）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（一）标的公司所处细分行业的市场规模、竞争格局、技术发展趋势，标的公司的核心技术是否符合技术发展趋势，是否存在被迭代的风险。结合标的公司的经营规模、市场占有率等说明其所处行业地位和竞争优势优势

标的公司	所属细分行业	市场规模	竞争格局	技术发展趋势	标的公司的核心技术是否符合技术发展趋势，是否存在被迭代的风险
PCB	印刷电路板（PCB）上游的电子信息互连材料	全球PCB市场规模达135.6亿美元，预计2025-2029年CAGR达8.3%。中国占全球覆铜板产能约74.8%，是全球最大的覆铜板生产与消费国。	全球市场呈现寡头竞争格局，主要玩家包括：南亚新材、深南电路、沪电股份、生益科技、台光电子、材料股份等。国内企业凭借成本优势，在低端市场占据主导地位，但在高端市场仍面临国际巨头的竞争。	PCB行业技术迭代较快，主要受下游消费电子、汽车电子、工业控制等行业需求驱动。高端PCB向高多层、高密度、高可靠性方向发展，对材料性能要求持续提升。	安德利公司主营FR4产品，属于PCB上游材料，技术成熟，市场稳定，不存在被迭代风险。
FR4	通用型覆铜板	全球FR4市场规模约1000亿元，预计2025-2029年CAGR达8.3%。	全球市场呈现寡头竞争格局，主要玩家包括：南亚新材、深南电路、沪电股份、生益科技、台光电子、材料股份等。国内企业凭借成本优势，在低端市场占据主导地位，但在高端市场仍面临国际巨头的竞争。	FR4产品技术迭代较慢，主要受下游消费电子、汽车电子、工业控制等行业需求驱动。高端FR4向高多层、高密度、高可靠性方向发展，对材料性能要求持续提升。	安德利公司主营FR4产品，属于PCB上游材料，技术成熟，市场稳定，不存在被迭代风险。
高速覆铜板	高速覆铜板	全球高速覆铜板市场规模约1000亿元，预计2025-2029年CAGR达8.3%。	全球市场呈现寡头竞争格局，主要玩家包括：南亚新材、深南电路、沪电股份、生益科技、台光电子、材料股份等。国内企业凭借成本优势，在低端市场占据主导地位，但在高端市场仍面临国际巨头的竞争。	高速覆铜板技术迭代较快，主要受下游消费电子、汽车电子、工业控制等行业需求驱动。高端高速覆铜板向高多层、高密度、高可靠性方向发展，对材料性能要求持续提升。	安德利公司主营高速覆铜板，属于PCB上游材料，技术成熟，市场稳定，不存在被迭代风险。
高端覆铜板	高端覆铜板	全球高端覆铜板市场规模约1000亿元，预计2025-2029年CAGR达8.3%。	全球市场呈现寡头竞争格局，主要玩家包括：南亚新材、深南电路、沪电股份、生益科技、台光电子、材料股份等。国内企业凭借成本优势，在低端市场占据主导地位，但在高端市场仍面临国际巨头的竞争。	高端覆铜板技术迭代较快，主要受下游消费电子、汽车电子、工业控制等行业需求驱动。高端高端覆铜板向高多层、高密度、高可靠性方向发展，对材料性能要求持续提升。	安德利公司主营高端覆铜板，属于PCB上游材料，技术成熟，市场稳定，不存在被迭代风险。

（二）分产品类别说明标的公司技术产业化情况、产品验证进展，是否实现规模化量产，与主要客户的合作阶段及收入实现情况。请公司补充披露：（1）标的公司所处细分行业的市场规模、竞争格局、技术发展趋势，标的公司的核心技术是否符合技术发展趋势，是否存在被迭代的风险，结合标的公司的经营规模、市场占有率等说明其所处行业地位和竞争优势优势；（2）分产品类别说明标的公司技术产业化情况、产品验证进展，是否实现规模化量产，与主要客户的合作阶段及收入实现情况；（3）本次交易收购后整合管控的措施安排，标的公司是否具备跨行业经营的经验、能力，如何保障对子公司的有效管理；（4）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

标的公司	所属细分行业	市场规模	竞争格局	技术发展趋势	标的公司的核心技术是否符合技术发展趋势，是否存在被迭代的风险
PCB	印刷电路板（PCB）上游的电子信息互连材料	全球PCB市场规模达135.6亿美元，预计2025-2029年CAGR达8.3%。中国占全球覆铜板产能约74.8%，是全球最大的覆铜板生产与消费国。	全球市场呈现寡头竞争格局，主要玩家包括：南亚新材、深南电路、沪电股份、生益科技、台光电子、材料股份等。国内企业凭借成本优势，在低端市场占据主导地位，但在高端市场仍面临国际巨头的竞争。	PCB行业技术迭代较快，主要受下游消费电子、汽车电子、工业控制等行业需求驱动。高端PCB向高多层、高密度、高可靠性方向发展，对材料性能要求持续提升。	安德利公司主营FR4产品，属于PCB上游材料，技术成熟，市场稳定，不存在被迭代风险。
FR4	通用型覆铜板	全球FR4市场规模约1000亿元，预计2025-2029年CAGR达8.3%。	全球市场呈现寡头竞争格局，主要玩家包括：南亚新材、深南电路、沪电股份、生益科技、台光电子、材料股份等。国内企业凭借成本优势，在低端市场占据主导地位，但在高端市场仍面临国际巨头的竞争。	FR4产品技术迭代较慢，主要受下游消费电子、汽车电子、工业控制等行业需求驱动。高端FR4向高多层、高密度、高可靠性方向发展，对材料性能要求持续提升。	安德利公司主营FR4产品，属于PCB上游材料，技术成熟，市场稳定，不存在被迭代风险。
高速覆铜板	高速覆铜板	全球高速覆铜板市场规模约1000亿元，预计2025-2029年CAGR达8.3%。	全球市场呈现寡头竞争格局，主要玩家包括：南亚新材、深南电路、沪电股份、生益科技、台光电子、材料股份等。国内企业凭借成本优势，在低端市场占据主导地位，但在高端市场仍面临国际巨头的竞争。	高速覆铜板技术迭代较快，主要受下游消费电子、汽车电子、工业控制等行业需求驱动。高端高速覆铜板向高多层、高密度、高可靠性方向发展，对材料性能要求持续提升。	安德利公司主营高速覆铜板，属于PCB上游材料，技术成熟，市场稳定，不存在被迭代风险。
高端覆铜板	高端覆铜板	全球高端覆铜板市场规模约1000亿元，预计2025-2029年CAGR达8.3%。	全球市场呈现寡头竞争格局，主要玩家包括：南亚新材、深南电路、沪电股份、生益科技、台光电子、材料股份等。国内企业凭借成本优势，在低端市场占据主导地位，但在高端市场仍面临国际巨头的竞争。	高端覆铜板技术迭代较快，主要受下游消费电子、汽车电子、工业控制等行业需求驱动。高端高端覆铜板向高多层、高密度、高可靠性方向发展，对材料性能要求持续提升。	安德利公司主营高端覆铜板，属于PCB上游材料，技术成熟，市场稳定，不存在被迭代风险。

（三）本次交易收购后整合管控的措施安排，标的公司是否具备跨行业经营的经验、能力，如何保障对子公司的有效管理；（4）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（四）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

标的公司	所属细分行业	市场规模	竞争格局	技术发展趋势	标的公司的核心技术是否符合技术发展趋势，是否存在被迭代的风险
PCB	印刷电路板（PCB）上游的电子信息互连材料	全球PCB市场规模达135.6亿美元，预计2025-2029年CAGR达8.3%。中国占全球覆铜板产能约74.8%，是全球最大的覆铜板生产与消费国。	全球市场呈现寡头竞争格局，主要玩家包括：南亚新材、深南电路、沪电股份、生益科技、台光电子、材料股份等。国内企业凭借成本优势，在低端市场占据主导地位，但在高端市场仍面临国际巨头的竞争。	PCB行业技术迭代较快，主要受下游消费电子、汽车电子、工业控制等行业需求驱动。高端PCB向高多层、高密度、高可靠性方向发展，对材料性能要求持续提升。	安德利公司主营FR4产品，属于PCB上游材料，技术成熟，市场稳定，不存在被迭代风险。
FR4	通用型覆铜板	全球FR4市场规模约1000亿元，预计2025-2029年CAGR达8.3%。	全球市场呈现寡头竞争格局，主要玩家包括：南亚新材、深南电路、沪电股份、生益科技、台光电子、材料股份等。国内企业凭借成本优势，在低端市场占据主导地位，但在高端市场仍面临国际巨头的竞争。	FR4产品技术迭代较慢，主要受下游消费电子、汽车电子、工业控制等行业需求驱动。高端FR4向高多层、高密度、高可靠性方向发展，对材料性能要求持续提升。	安德利公司主营FR4产品，属于PCB上游材料，技术成熟，市场稳定，不存在被迭代风险。
高速覆铜板	高速覆铜板	全球高速覆铜板市场规模约1000亿元，预计2025-2029年CAGR达8.3%。	全球市场呈现寡头竞争格局，主要玩家包括：南亚新材、深南电路、沪电股份、生益科技、台光电子、材料股份等。国内企业凭借成本优势，在低端市场占据主导地位，但在高端市场仍面临国际巨头的竞争。	高速覆铜板技术迭代较快，主要受下游消费电子、汽车电子、工业控制等行业需求驱动。高端高速覆铜板向高多层、高密度、高可靠性方向发展，对材料性能要求持续提升。	安德利公司主营高速覆铜板，属于PCB上游材料，技术成熟，市场稳定，不存在被迭代风险。
高端覆铜板	高端覆铜板	全球高端覆铜板市场规模约1000亿元，预计2025-2029年CAGR达8.3%。	全球市场呈现寡头竞争格局，主要玩家包括：南亚新材、深南电路、沪电股份、生益科技、台光电子、材料股份等。国内企业凭借成本优势，在低端市场占据主导地位，但在高端市场仍面临国际巨头的竞争。	高端覆铜板技术迭代较快，主要受下游消费电子、汽车电子、工业控制等行业需求驱动。高端高端覆铜板向高多层、高密度、高可靠性方向发展，对材料性能要求持续提升。	安德利公司主营高端覆铜板，属于PCB上游材料，技术成熟，市场稳定，不存在被迭代风险。

注：量产标准以年销售收入超100万元，非行业性标准，下同。M8等级材料为PCB上游材料，属于PCB上游材料，技术成熟，市场稳定，不存在被迭代风险。

（五）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（六）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（七）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（八）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

周期较长的典型特征，且终端客户验证需与PCB企业协同进行，下游客户对材料的技术指标、一致性、可靠性的要求严苛，新品从导入到规模化应用通常需经历较长的测试与验证周期，标的公司提示投资者关注标的公司核心技术被迭代的风险，具体参见本回复之“风险提示”。

5.结合标的公司的经营规模、市场占有率等说明其所处行业地位和竞争优势优势
（1）标的公司所处行业地位
标的公司2025年实现营业收入22,401.52万元，相比行业龙头企业台光电子、生益科技等规模较小，市场占有率1%。但标的公司已具备M8级别及以上高速覆铜板产品的研发及生产能力。

（2）标的公司的竞争优势
标的公司竞争优势主要体现在：
①独立研发的核心技术
标的公司主营业务属于集成电路电子信息互连材料领域，主要包含了树脂材料设计、填料表面处理及界面增强技术、高频通孔技术、量产工艺技术和下游应用技术等关键环节，每个环节都有较高的技术门槛，需要多年的技术积累和沉淀才能有所突破。

②多年的自主研发经验
标的公司高度重视自主研发与创新，组建创新团队40余人，其中博士5名、硕士10余名。标的公司近年还设立了多个企业研究院，浙江省博士后工作站、宁波市企业技术研发中心、宁波市博士后工作站等研发平台，并承担了多项国家级、省市级关键核心技术攻关项目，构建了完善的技术研发和专利体系，已获得多项授权专利，主要覆盖配方优化、生产工艺、设备创新、检测技术等领域。

③优质的客户资源
标的公司拥有深厚的行业资源及市场开拓能力，认证周期长的终端客户具有深厚的合作基础，高端材料直接客户、终端客户销售情况参见本回复问题3之“（一）1.标的最近两年一期前五名客户情况”。标的公司该客户资源为其供应链体系后端持续为标的公司带来高粘性，同时也将推动标的公司不断进行技术投入并积极满足下游行业发展的终端客户需求。

④产品结构持续优化，打造未来增长空间
标的公司M8和M9等级高速覆铜板产品可以支撑下游需求，已经通过终端客户的认证，标的公司M10等级高速覆铜板产品正在参与国际头部客户下一代产品的认证。标的公司承担了国家专项、专项、PCB-BGA封装基板关键结构设计与改性、填料表面处理、微米级封装、纳米级封装分散以及高频、基材料表面处理等关键技术，成功研发150系列多款低损耗、低CET封装基材料，伴随下游市场需求的持续增长及生产工艺成熟度的提高，标的公司高性能覆铜板产品有望打开增长空间。

（二）分产品类别说明标的公司技术产业化情况、产品验证进展，是否实现规模化量产，与主要客户的合作阶段及收入实现情况。
截至本回复出具日，标的公司主要产品为PR4、高速覆铜板等，具体情况如下：

（1）PR4
标的公司PR4产品主要适用于智能手机、智能PC等终端的高多层HDI应用市场，主要客户为胜宏科技、弘讯科技等。标的公司PR4产品2025年实现销售约15,864.01万元，2026年1-3月实现销售约1,830.50万元。具体情况如下：

年份	产品型号	是否实现量产	是否获得终端客户验证	是否实现量产	2026年营业收入（万元）
2025年1-3月	FR4-2025-001-002-003	是	是	是	786.24
2025年4-6月	FR4-2025-004-005-006	是	是	是	15,864.01

（2）高速覆铜板
标的公司M4-M9等级高速覆铜板产品已具备产业化生产能力，已通过终端客户验证并实现量产，尚未达到规模化生产阶段。标的公司高速覆铜板产品的主要客户为胜宏科技、方正科技、深南电路、胜宏科技等PCB龙头企业，实现以上收入（具体交易数据参见本回复问题3之“（一）1.标的最近两年一期前五名客户情况”）。标的公司高速覆铜板产品2025年累计实现销售约1,265.78万元，2026年1-3月实现销售约460.71万元。具体情况如下：

年份	产品型号	是否实现量产	是否获得终端客户验证	是否实现量产	2026年营业收入（万元）
2025年1-3月	FR4-2025-001-002-003	是	是	是	786.24
2025年4-6月	FR4-2025-004-005-006	是	是	是	15,864.01

注：M9产品为Gallop 90于2026年1-5月已实现现过100万元收入。

（3）高端覆铜板
标的公司高端覆铜板技术已实现产业化、产品实现规模化量产，主要应用于天线、连接器等领域，主要客户为海信集团，订单较为稳定。标的公司高端覆铜板产品2025年实现销售约940.57万元，2026年1-3月实现销售约77.10万元。

年份	产品型号	是否实现量产	是否获得终端客户验证	是否实现量产	2026年营业收入（万元）
2025年1-3月	FR4-2025-001-002-003	是	是	是	786.24
2025年4-6月	FR4-2025-004-005-006	是	是	是	15,864.01

（四）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（五）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（六）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（七）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（八）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（九）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（十）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（十一）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（十二）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（十三）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（十四）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（十五）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（十六）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（十七）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（十八）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（十九）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（二十）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（二十一）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（二十二）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（二十三）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（二十四）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（二十五）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（二十六）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（二十七）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（二十八）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

（二十九）结合前述问题以及公司主营业务经营情况、业务布局及发展战略等，说明本次收购对行业并购、收购资产投资的必要性、合理性；（5）本次收购对于上市公司及投资者利益保护的具体安排，是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者的利益。

本次交易价格以资产评估结果为依据，通过双方谈判协商达成，上市公司为便于广大投资者对本次交易定价公允性进行判断，保障中小投资者合法权益，将聘请具有专业资质的中介机构，对本次交易方案及过程进行监督并出具专业意见，确保本次交易定价公允、公平、合理。

（3）通过多种措施管控标的公司，提高其综合竞争力
本次交易完成后，上市公司将从多维度对标的公司实施整合管控。业务方面，上市公司依托实体制造领域的积累，将帮助标的公司提升治理能力和成本管控能力。市场方面，依托上市公司的平台优势，积极布局下游产业链，稳固标的公司的产业地位。机构及人员方面，鉴于电子材料行业对技术迭代的高度依赖，交易完成后将继续由创始人等核心成员主导关键技术路线决策，并通过长期劳动合同、竞业限制协议、股权激励等绑定核心人才，保障标的公司技术团队、客户关系及业务经营的稳定性，切实维护上市公司及股东的合法权益。

2.是否设置公司治理安排、业绩承诺或补偿机制等保障措施，是否充分考虑上市公司及中小投资者利益
目前本次收购审计、评估工作尚未完成，正式协议尚未签署，公司将在后续谈判中，结合标的公司行业特点、与控股股东、核心团队协商设置合理的交易条款，维护上市公司及中小投资者利益。

问题2：关于估值与资金来源
公告披露，截至2026年3月末，标的公司净资产2.12亿元，本次交易定价较年初初预计为6-8亿元，交易资金通过自有、自筹等方式解决。截至2026年3月31日，公司账面货币资金及交易性金融资产余额为人民币7.17亿元。

请公司补充披露：（1）目前对标的公司的尽调进展及审计、评估计划安排，本次交易定价的确定依据，主要估值参数及交易估值情况，结合标的公司历史业绩及股权结构让估值情况，市场可类比案例估值作价情况等，说明本次交易定价是否合理；（2）结合公司现金流、日常运营资金需求、本次交易资金支付安排及未来资金投入计划等，量化分析本次交易对公司现金流、财务状况及日常经营的影响，公司拟采取的应对措施。

（一）目前对标的公司的尽调进展及审计、评估计划安排，本次交易定价的确定依据，主要估值参数及交易估值情况，结合标的公司历史业绩及股权结构让估值情况，市场可类比案例估值作价情况等，说明本次交易定价是否合理；（2）结合公司现金流、日常运营资金需求、本次交易资金支付安排及未来资金投入计划等，量化分析本次交易对公司现金流、财务状况及日常经营的影响，公司拟采取的应对措施。

（二）结合公司现金流、日常运营资金需求、本次交易资金支付安排及未来资金投入计划等，量化分析本次交易对公司现金流、财务状况及日常经营的影响，公司拟采取的应对措施。

（三）结合公司现金流、日常运营资金需求、本次交易资金支付安排及未来资金投入计划等，量化分析本次交易对公司现金流、财务状况及日常经营的影响，公司拟采取的应对措施。

（四）结合公司现金流、日常运营资金需求、本次交易资金支付安排及未来资金投入计划等，量化分析本次交易对公司现金流、财务状况及日常经营的影响，公司拟采取的应对措施。

（五）结合公司现金流、日常运营资金需求、本次交易资金支付安排及未来资金投入计划等，量化分析本次交易对公司现金流、财务状况及日常经营的影响，公司拟采取的应对措施。

（六）结合公司现金流、日常运营资金需求、本次交易资金支付安排及未来资金投入计划等，量化分析本次交易对公司现金流、财务状况及日常经营的影响，公司拟采取的应对措施。

（七）结合公司现金流、日常运营资金需求、本次交易资金支付安排及未来资金投入计划等，量化分析本次交易对公司现金流、财务状况及日常经营的影响，公司拟采取的应对措施。

（八）结合公司现金流、日常运营资金需求、本次交易资金支付安排及未来资金投入计划等，量化分析本次交易对公司现金流、财务状况及日常经营的影响，公司拟采取的应对措施。

（九）结合公司现金流、日常运营资金需求、本次交易资金支付安排及未来资金投入计划等，量化分析本次交易对公司现金流、财务状况及日常经营的影响，公司拟采取的应对措施。

（十）结合公司现金流、日常运营资金需求、本次交易资金支付安排及未来资金投入计划等，量化分析本次交易对公司现金流、财务状况及日常经营的影响，公司拟采取的应对措施。

（十一）结合公司现金流、日常运营资金需求、本次交易资金支付安排及未来资金投入计划等，量化分析本次交易对公司现金流、财务状况及日常经营的影响，公司拟采取的应对措施。

（十二）结合公司现金流、日常运营资金需求、本次交易资金支付安排及未来资金投入计划等，量化分析本次交易对公司现金流、财务状况及日常经营的影响，公司拟采取的应对措施。

（十三）结合公司现金流、日常运营资金需求、本次交易资金支付安排及未来资金投入计划等，量化分析本次交易对公司现金流、财务状况及日常经营的影响，公司拟采取的应对措施。

（十四）结合公司现金流、日常运营资金需求、本次交易资金支付安排及未来资金投入计划等，量化分析本次交易对公司现金流、财务状况及日常经营的影响，公司拟采取的应对措施。

（十五）结合公司现金流、日常运营资金需求、